苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五 次会议通知已于2023年3月22日通过电子邮件方式送达。会议于2023年3月 27 日以现场和通讯相结合表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持,公司监事会主 席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定, 会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要, 更好地支持业务的拓展, 保证战略的实 施,公司及子公司拟向银行申请以下综合授信额度:

- (1) 公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 15.000 万元的综合授信额度:
- (2) 公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 15,000 万 元的综合授信额度;
- (3) 公司及全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司拟向中信银行股份有限 公司苏州分行申请不超过人民币 25.000 万元的综合授信额度。

上述授信额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环滚动使用,并提请 董事会授权董事长签署授信额度内有关的法律文件。本次向银行申请综合授信额 度为公司及子公司日常生产经营需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会 2023年3月27日